

中信证券股份有限公司

关于有研半导体硅材料股份公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为有研半导体硅材料股份公司（以下简称“有研硅”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对有研硅拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2047号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）18,714.3158万股，每股面值1.00元，每股发行价格为9.91元。

本次公开发行募集资金总额为185,458.87万元，扣除总发行费用19,062.15万元（不含增值税），募集资金净额为166,396.72万元。上述募集资金已全部到位，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到账情况进行了审验，并于2022年11月7日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2201588号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。具体情况详见2022年11月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次首次公开发行股票募集资金投资项目情况计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资金额	拟投入募集资金金额
1	集成电路用 8 英寸硅片扩产项目	山东有研半导体	38,482.43	38,482.43
2	集成电路刻蚀设备用硅材料项目	山东有研半导体	35,734.76	35,734.76
3	补充研发与营运资金	有研硅	25,782.81	25,782.81
合计			100,000.00	100,000.00

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

结合公司资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《有研半导体硅材料股份公司募集资金管理制度》等规章制度的规定，在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金。公司超募资金总额为 66,396.72 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 19,500.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.37%。

四、本次使用部分超募资金对公司的影响、相关说明和承诺

本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，本次使用部分超募资金永久补充流动资金可以满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，进一步提高公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益符合法律法规的相关规定。

公司承诺每十二个月内累计用于永久补充流动资金的超募资金不超过超募资金总额的 30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求；在本次永久性补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、公司履行的审议程序

2023 年 3 月 28 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议，审

议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 19,500.00 万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，本事项尚需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

(一) 独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。该部分超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。经过认真审核，公司本次部分超募资金的使用计划，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《有研半导体硅材料股份公司募集资金管理制度》的规定。

因此，全体独立董事同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二) 监事会意见

监事会认为：公司本次使用 19,500 万元超募资金永久补充流动资金事项，其决策的内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定和《有研半导体硅材料股份公司募集资金管理办法》等规章制度的规定，在保证本次发行募集资金投资项目建设资金需求的前提下，更好地满足了公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经

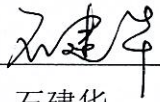
公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《有研半导体硅材料股份公司募集资金管理制度》。公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

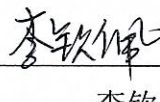
综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金无异议。

((以下无正文))

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于有研半导体硅材料股份公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人：


石建华


李钦佩

